日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 5月13日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-134087

[ST. 10/C]:

[JP2003-134087]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

.

2003年10月 2日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office **今井康**



【書類名】 特許願

【整理番号】 2174050003

【提出日】 平成15年 5月13日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01G 9/048

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子部品株式

会社内

【氏名】 藤山 輝己

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

ページ: 2/E

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 シート形電解コンデンサ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極電極箔が片面に接続された陽極シートと、陰極電極箔が片面に接続された陰極シートと、上記陽極電極箔と陰極電極箔を対向させてその間に配設され、かつ駆動用電解液が含浸されたセパレータと、このセパレータを挟み込んだ陽極電極箔と陰極電極箔からなる電極部分が嵌まり込む開口部を設けて上記陽極シートと陰極シートの間に配設され、上記電極部分を封止すると共に陽極シートと陰極シートを一体に接合した封止シートからなるシート形電解コンデンサ。

【請求項2】 陽極シートならびに陰極シートにICの接続用ピンが嵌まり込む貫通孔と、この貫通孔の中で上記ICの接続用ピンとの電気的接続が必要な貫通孔内にコンタクト部を夫々設けた請求項1に記載のシート形電解コンデンサ。

【請求項3】 I Cの接続用ピンが嵌まり込む貫通孔と、この貫通孔の中で上記 I Cの接続用ピンとの電気的接続が必要な貫通孔内にコンタクト部を夫々設けたコネクタを陽極シートならびに陰極シートに夫々電気的に接続した請求項1に記載のシート形電解コンデンサ。

【請求項4】 I Cの接続用ピンと電気的に接続されるコンタクト部を楕円形にし、この楕円形の長径方向が丸形の I Cの接続用ピンの直径よりも長く、同短径方向が同直径よりも短いように形成した請求項2または3に記載のシート形電解コンデンサ。

【請求項5】 陽極シートならびに陰極シートおよび/またはコネクタを、金めっきまたは表面に絶縁コーティングを施した弾性を有する導電性の金属により構成した請求項1または3に記載のシート形電解コンデンサ。

【請求項6】 複数の陽極電極箔と陰極電極箔を夫々その間にセパレータを介在させて交互に積層し、陽極電極箔を陽極シートに、陰極電極箔を陰極シートに 夫々電気的に接続した請求項1に記載のシート形電解コンデンサ。

【請求項7】 陽極電極箔が片面に接続された陽極シートと、陰極電極箔が片面に接続された陰極シートに代えて、アルミニウム箔の片面の一部をエッチング

して化成処理した陽極電極部が形成された陽極シートと、アルミニウム箔の片面 の一部をエッチングして陰極電極部が形成された陰極シートを用いた請求項1ま たは2に記載のシート形電解コンデンサ。

【請求項8】 駆動用電解液としてゲル状の駆動用電解液を用いた請求項1に 記載のシート形電解コンデンサ。

【請求項9】 駆動用電解液が含浸されたセパレータに代えて、略球状のスペーサを駆動用電解液に混入した請求項1に記載のシート形電解コンデンサ。

【請求項10】 シート形電解コンデンサの中心部に凹部を形成し、この凹部内に電極部分が配設されるようにした請求項1に記載のシート形電解コンデンサ

【請求項11】 外表面を絶縁コーティングまたは絶縁シートにより被覆した 請求項1に記載のシート形電解コンデンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は高速ICやプロセッサの平滑ならびにノイズ吸収等に使用されるシート形電解コンデンサに関するものである。

[00002]

【従来の技術】

近年、パーソナルコンピュータや通信機器の高速化が進められている中で、これらに使用される電子部品の小型化や高周波対応化が要求されている。これに伴い電子部品の一つであるコンデンサについても大容量化、低インピーダンス化が必要となり、特に、コンピュータのCPU駆動用電源回路は、回路設計上、高周波対応としてノイズやリップル電流の吸収性が要求され、低ESR(等価直列抵抗)化、低ESL(等価直列インダクタンス)化、耐高リップル電流化、大容量化を実現することができる電解コンデンサが強く求められており、このような要求に対応するため、CPUの周辺にはCPUに近接する位置に小形のチップ形コンデンサが多数配置されているのが実態であった。

[0003]

図10はPentium(インテル社の登録商標)4で代表されるCPU周りを示したものであり、図10において1はCPUに代表されるIC、2はこのIC1の下面に設けられた接続用ピン、3はICソケット、4はこのICソケット3が半田付けされたプリント配線板であり、このように構成されたCPUに近接するようにチップ形コンデンサ53を実装しているものであった。また、図示はしていないが、この周辺に大容量の電解コンデンサを配置し、CPUの急激な電流変化に対応しているものもあった。

[0004]

なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献1が知られている。

[0005]

【特許文献1】

特開昭60-130150号公報

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら上記従来のCPU周りのチップ形コンデンサ53の実装状態においては、IC1には478本の接続用ピン2があり、かつICソケット3のプリント配線板4上においてはIC1からの引き出し用の配線パターン(図示せず)が設けられているためにIC1周辺のチップ形コンデンサ53や図示しない他の電子部品の実装位置が遠ざかりつつあると共に、実装面積が不足しつつあるという問題を有していた。

[0007]

一方、CPUの動作周波数は上昇の一途をたどっており、ノイズ吸収及び電流供給のために大容量で低ESR、かつ低ESLのチップ形コンデンサをCPUにできるだけ近付けなければならないという相反する状況となっており、現行技術のみでは対応し切れなくなりつつあるというのが実態であった。

[0008]

その一要因として、CPUのICソケット3の高さが約3mm、ICソケット 3からチップ形コンデンサ53までの距離が数十mmあるため、CPUに対して ESLが上昇し、構造上高周波になるほどインピーダンスが上昇し、高周波領域で低ESLのコンデンサの性能を十分発揮できないということが挙げられる。

[0009]

本発明はこのような従来の課題を解決し、大容量で低ESLの電子部品をICのすぐ近傍で接続することにより、ICの周辺回路の実装面積を増やすことができるシート形電解コンデンサを提供することを目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために本発明の請求項1に記載の発明は、陽極電極箔が片面に接続された陽極シートと、陰極電極箔が片面に接続された陰極シートと、上記陽極電極箔と陰極電極箔を対向させてその間に配設され、かつ駆動用電解液が含浸されたセパレータと、このセパレータを挟み込んだ陽極電極箔と陰極電極箔からなる電極部分が嵌まり込む開口部を設けて上記陽極シートと陰極シートの間に配設され、上記電極部分を封止すると共に陽極シートと陰極シートを一体に接合した封止シートからなる構成としたものであり、これにより、陽極/陰極シートから陽極/陰極電極箔に夫々直接電気を供給することができるためにESRを低く保つことができるようになり、また、陽極シートと陰極シートの電気導通経路が密着しているためにESLも低く保つことができるようになり、さらに、構造上製品全体の厚みを薄く構成することができるという作用効果を有する。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明の請求項2に記載の発明は、陽極シートならびに陰極シートにICの接続用ピンが嵌まり込む貫通孔と、この貫通孔の中で上記ICの接続用ピンとの電気的接続が必要な貫通孔内にコンタクト部を夫々設けた構成としたものであり、これにより、ICとICソケット間に本発明のシート形電解コンデンサを挟み込むことができるようになるためにプリント基板上にシート形電解コンデンサを実装するためのスペースが不要となり、また、CPUにおいては一般的に約1/4~1/3が同系統の電源ラインで構成されているために複数の電源用ピンを一括して接続することができるという作用効果を有する。

[0012]

5/

本発明の請求項3に記載の発明は、ICの接続用ピンが嵌まり込む貫通孔と、この貫通孔の中で上記ICの接続用ピンとの電気的接続が必要な貫通孔内にコンタクト部を夫々設けたコネクタを陽極シートならびに陰極シートに夫々電気的に接続した構成のものであり、これにより、コンタクト部は弾性を有するバネ材を使用することが可能となり、ICへの挿抜を行う際の信頼性を大きく向上させることができるようになるという作用効果を有する。

[0013]

本発明の請求項4に記載の発明は、ICの接続用ピンと電気的に接続されるコンタクト部を楕円形にし、この楕円形の長径方向が丸形のICの接続用ピンの直径よりも長く、同短径方向が同直径よりも短いように形成した構成のものであり、これにより、コンタクト部にエッジが無いために亀裂が入り難く、しかもICの接続用ピンと確実な接続が得られるようになるという作用効果を有する。

[0014]

本発明の請求項5に記載の発明は、陽極シートならびに陰極シートおよび/またはコネクタを、金めっきまたは表面に絶縁コーティングを施した弾性を有する導電性の金属により構成したものであり、これにより、駆動用電解液による陽極シートならびに陰極シートの腐食を防止することができるようになると共に、コンタクト部は弾性を有するバネ材を使用することが可能となり、ICへの挿抜を行う際の信頼性を大きく向上させることができるようになるという作用効果を有する。

[0015]

本発明の請求項6に記載の発明は、複数の陽極電極箔と陰極電極箔を夫々その間にセパレータを介在させて交互に積層し、陽極電極箔を陽極シートに、陰極電極箔を陰極シートに夫々電気的に接続した構成のものであり、これにより、製品容量を増やすことができるという作用効果を有する。

[0016]

本発明の請求項7に記載の発明は、陽極電極箔が片面に接続された陽極シートと、陰極電極箔が片面に接続された陰極シートに代えて、アルミニウム箔の片面の一部をエッチングして化成処理した陽極電極部が形成された陽極シートと、ア

ルミニウム箔の片面の一部をエッチングして陰極電極部が形成された陰極シートを用いた構成のものであり、これにより、陽極/陰極電極部と陽極/陰極シートの接続が不要となると共に接続抵抗が無くなるため、ESRを低くすることができ、また、部品点数が減少して組み立てが簡単になるという作用効果を有する。

[0017]

本発明の請求項8に記載の発明は、駆動用電解液としてゲル状の駆動用電解液 を用いた構成のものであり、これにより、電極構成部分を封止する際に、駆動用 電解液が流出することによる封止不具合を防止することができるという作用効果 を有する。

[0018]

本発明の請求項9に記載の発明は、駆動用電解液が含浸されたセパレータに代えて、略球状のスペーサを駆動用電解液に混入した構成のものであり、これにより、スペーサの径により電極間隔を数 μ mから数十 μ mの任意の薄い間隔に保つことができるようになるため、セパレータを使用する場合よりもESRを低くすることができるようになるという作用効果を有する。

[0019]

本発明の請求項10に記載の発明は、シート形電解コンデンサの中心部に凹部を形成し、この凹部内に電極部分が配設されるようにした構成のものであり、これにより、電極部分を積層して厚くなった場合でも無理なく収容することができ、また、電極部分の封止工程において駆動用電解液の流出を防止することができ、さらには、シート形電解コンデンサの逆挿入を防止することができるという作用効果を有する。

[0020]

本発明の請求項11に記載の発明は、外表面を絶縁コーティングまたは絶縁シートにより被覆した構成のものであり、これにより、同一プリント配線板に実装される他の電子部品との接触による漏電を防止することができるという作用効果を有する。

[0021]

【発明の実施の形態】

(実施の形態1)

以下、実施の形態 1 を用いて、本発明の特に請求項 1, 2, 4, 5, 6, 8, 1 1 に記載の発明について説明する。

[0022]

図1は本発明の実施の形態1によるシート形電解コンデンサとこの使用状態を示した分解斜視図、図2は同シート形電解コンデンサにICを接続した状態を示した断面図であり、図1、図2において、1はCPUに代表されるIC、2はこのIC1の下面に設けられた接続用ピンを示し、本実施の形態ではPentium(インテル社の登録商標)4(2.8GHz)用のICパッケージとして478ピンのFC-PGA2を用いた例を示したものである。3はICソケット、4はこのICソケット3が半田付けされたプリント配線板である。

[0023]

5は本発明のシート形電解コンデンサであり、このシート形電解コンデンサ5には上記IC1の接続用ピン2が貫通する貫通孔6が設けられ、かつIC1の接続に必要な接続用ピン2が貫通する貫通孔6にのみ、接続用ピン2と導通するコンタクト部7(図中の黒色塗りつぶし部分)が形成された構成となっており、上記IC1の接続用ピン2をシート形電解コンデンサ5の貫通孔6を貫通させてICソケット3に装着することにより、コンタクト部7を介してIC1とシート形電解コンデンサ5を導通させることができるものである。

$[0\ 0\ 2\ 4]$

なお、図2において6aは接続用ピン2が接続されない貫通孔、6bはコンタクト部7aにより陽極電源ピン2aが接続される貫通孔、6cはコンタクト部7bにより陰極電源ピン2bが接続される貫通孔である。

[0025]

図3は上記シート形電解コンデンサ5の構成を示した分解斜視図、図4は同断面図であり、図3、図4において8は陰極シートを示し、この陰極シート8はバネ用リン青銅に金めっきを施した導電体よりなり、上記IC1の接続用ピン2のピッチに合わせた貫通孔6とIC1の陰極電源ピン2bが接続されるコンタクト部7bが形成されている。9は陰極電極箔であり、上記陰極シート8の略中央部

に超音波溶着や冷間プレス等の方法により接合されて接続部10を形成し、この接続部10によって電気的な接続と機械的な接合がなされたものである。11は陽極シートを示し、この陽極シート11はバネ用リン青銅に金めっきを施した導電体よりなり、上記IC1の接続用ピン2のピッチに合わせた貫通孔6とIC1の陽極電源ピン2aが接続されるコンタクト部7aが形成されている。12は陽極電極箔であり、上記陽極シート11の略中央部に超音波溶着や冷間プレス等の方法により接合されて接続部10を形成し、この接続部10によって電気的な接続と機械的な接合がなされたものである。

[0026]

13はセパレータであり、このセパレータ13は図示しないゲル状の電解液が 含浸されて上記陰極シート8と陽極シート11の間に配設されることにより、セパレータ13を挟んで陰極電極箔9と陽極電極箔12が対向するように構成されるものである。14はポリエチレン、PET、エポキシ、メラミン、シリコン樹脂等の絶縁性を有した材料からなり、中央部に開口部が設けられた封止シートであり、上記陰極シート8と陽極シート11の間に配設されて接着または熱溶着することによりこれらを一体に接合すると共に、上記セパレータ13を挟んだ陰極電極箔9と陽極電極箔12を封止するようにしているものである。15と16は絶縁シートであり、上記IC1の接続用ピン2のピッチに合わせた貫通孔6を夫々設けて上記陰極シート8と陽極シート11の外表面側に夫々貼り付けられ、これにより本発明のシート形電解コンデンサを構成したものである。

[0027]

なお、上記陽極電極箔12とセパレータ13と陰極電極箔9よりなる電極構成部分を大気圧以下に減圧して封止するようにすれば、各電極がセパレータ13を介して密着するために電極間隔が安定し、個々の特性変化を小さくすることができるようになるものである。

[0028]

図5は本実施の形態によるシート形電解コンデンサのコンタクト部の構成を示したものであり、図中左側は陽極電源ピン2a挿入前を、同右は同挿入後の状態を示し、図5において17はIC1の陽極電源ピン2aが接続されるコンタクト

部7aに設けられた楕円形の貫通孔であり、この貫通孔17は長径方向が陽極電源ピン2aの直径よりも大きく、短径方向が同直径よりも小さい寸法に形成されることによってエッジ部が無いのでコンタクト部7aへのストレスによる亀裂が入り難いという特徴を有するものである。18は封止シート14に設けた貫通孔であり、陰極シート8の貫通孔19よりも小さい径に構成することにより絶縁性を確保しているものである。20は絶縁シート15に設けた貫通孔であり、貼りズレが生じても影響が少ないように、やや大き目に形成しているものである。

[0029]

図6は本実施の形態によるシート形電解コンデンサの電極箔を複数枚積層する場合の構成を示したものであり、図6において21は陰極電極箔、22はセパレータ、23は陽極電極箔、24は最端に配設される陽極電極箔23に一体で設けられた接合部を示し、同図に示すように、陰極電極箔21とセパレータ22と陽極電極箔23を交互に積層し、陰極電極箔21どうし、陽極電極箔23どうしを夫々電気的に接続し、陰極電極箔21を超音波溶着等の手段により陰極シート8に接続し、また、陽極電極箔23(または陰極電極箔21)の最端に位置する電極の一部を長くして形成された接合部24を陽極シート11に接続するように構成しているものである。

[0030]

このような構成にすることにより、陽極電極箔23に設けた接合部24により、陽極シート11を開いた状態で陽極シート11と陽極電極箔23を超音波溶着等の手段により電気的に接続することができ、また接合部24を折り曲げることにより陽極シート11と陰極シート8を閉じることができるようになるものである。

[0031]

(実施の形態2)

以下、実施の形態2を用いて、本発明の特に請求項7に記載の発明について説明する。

[0032]

図7は本発明の実施の形態2によるシート形電解コンデンサの構成を示した断

面図であり、本実施の形態は上記実施の形態1によるシート形電解コンデンサの 陽極/陰極シートの一部に陽極/陰極電極部を夫々形成したものである。

[0033]

図7において25はアルミニウムよりなる陰極シート、26はこの陰極シート25の片面の一部にエッチングにより表面積を拡大して形成された陰極電極部、27はアルミニウムよりなる陽極シート、28はこの陽極シート27の片面の一部にエッチングにより表面積を拡大し、かつ化成処理を行って形成された陽極電極部、29は駆動用電解液が含浸されて上記陰極電極部26と陽極電極部28の間に配設されたセパレータであり、このセパレータ29を挟んで陰極電極部26と陽極電極部28が対向するようにしているものである。30は上記陰極シート25と陽極シート27の陰極電極部26と陽極電極部28を設けた面の陰極電極部26と陽極電極部28を設けた面の陰極電極部26と陽極電極部28を設けた面の陰極電極部26と陽極電極部28を設けた面の陰極電極部26と陽極電極部28を設けた面の陰極電極部26と陽極電極部28を設けた面の陰極電極部26と陽極電極部28を設けた面の陰極電極部26と陽極電極部28を除く部分にラミネートされた高分子材料からなる封止シート、31と32は外装を絶縁するための絶縁シートである。

[0034]

このように構成される本実施の形態のシート形電解コンデンサは、アルミニウムからなる陰極シート25と陽極シート27の一方の面に陰極電極部26と陽極電極部28が形成される部分を開口した高分子材料からなる封止シート30を夫々ラミネートすると共に、他方の面に絶縁シート31と32を夫々ラミネートし、この陰極シート25と陽極シート27を図示しないエッチング槽に浸漬してエッチングを行うことにより陰極電極部26、陽極電極部28を形成し、さらに、上記陽極シート27に形成された陽極電極部28を図示しない化成槽に浸漬して陽極電極部28の化成を行った後、貫通孔およびコンタクト部をプレス加工により形成して陰極シート25と陽極シート27を作製する。

[0035]

続いて、この陰極シート25と陽極シート27を陰極電極部26と陽極電極部28が対向するように配置し、この間に駆動用電解液を含浸したセパレータ29を挟み込んだ後、このセパレータ29の周縁を熱プレス等の手段により加熱することによって高分子材料からなる封止シート30を熱溶着して封止して作製するようにしたものである。

[0036]

このような構成にすることにより、アルミニウムからなる陰極/陽極シート25,27の一部に陰極/陽極電極部26,28を一体に形成することができるため、陰極/陽極シート25,27と陰極/陽極電極部26,28の夫々の接続が不要となると共に接続抵抗が無くなり、この結果、ESRが低く、部品点数が少ないシート形電解コンデンサを提供することができるようになるものである。

[0037]

(実施の形態3)

以下、実施の形態3を用いて、本発明の特に請求項3,9に記載の発明について説明する。

[0038]

図8は本発明の実施の形態3によるシート形電解コンデンサの構成を示した断面図であり、図8において33は導電体よりなる陰極シート、34はこの陰極シート33の片面に接合された陰極電極箔、35は導電体よりなる陽極シート、36はこの陽極シート35の片面に接合された陽極電極箔であり、上記陰極電極箔34と陽極電極箔36が対向するように配設され、この間に駆動用電解液37の中に混入された球状のスペーサ38が介在されるように構成されている。

[0039]

39は上記陰極電極箔34と陽極電極箔36を球状のスペーサ38が混入された駆動用電解液37と共に封止する封止シート、40は弾性を有する導電体で形成した陰極コネクタ、41はこの陰極コネクタ40に設けられたICの陰極電源ピン2bが接続されるコンタクト部、42は弾性を有する導電体で形成した陽極コネクタ、43はこの陽極コネクタ42に設けられたICの陽極電源ピン2aが接続されるコンタクト部、44は陰極シート33と陰極コネクタ40および陽極シート35と陽極コネクタ42を夫々電気的に接続した接続部である。

$[0\ 0\ 4\ 0]$

このような構成にすることにより、陰極/陽極コネクタ40, 42は弾性を有するばね材を使用することが可能となり、これによりICへの挿抜を行う際の信頼性を大きく向上させることが可能になるものである。

[0041]

(実施の形態4)

以下、実施の形態 4 を用いて、本発明の特に請求項 1 0 に記載の発明について 説明する。

[0042]

図9は本発明の実施の形態4によるシート形電解コンデンサの構成を示した断面図であり、図9において45は導電体よりなる陰極シート、46はこの陰極シート45に形成された凹部、47はこの凹部46内の陰極シート45に接合された陰極電極箔、48は導電体よりなる陽極シート、49はこの陽極シート48に形成された凹部、50はこの凹部49内の陽極シート48に接合された陽極電極箔であり、上記陰極電極箔47と陽極電極箔50が対向するように配設され、この間に駆動用電解液が含浸されたセパレータ51が介在されるように構成されている。52は上記陰極電極箔47と陽極電極箔50を駆動用電解液が含浸されたセパレータ51と共に封止する封止シートである。

[0043]

このような構成にすることにより、電極部を積層して厚くなった場合でも無理なく収容することができるようになり、また、電極箔とセパレータの封止工程において駆動用電解液の流出を防止することができると共に水平で使用する場合液漏れの心配が無く、さらには、シート形電解コンデンサの逆挿入を防止することができるという効果を有するものである。

[0044]

【発明の効果】

以上のように本発明によるシート形電解コンデンサは、陽極電極箔が片面に接続された陽極シートと、陰極電極箔が片面に接続された陰極シートと、上記陽極電極箔と陰極電極箔を対向させてその間に配設され、かつ駆動用電解液が含浸されたセパレータと、このセパレータを挟み込んだ陽極電極箔と陰極電極箔からなる電極部分が嵌まり込む開口部を設けて上記陽極シートと陰極シートの間に配設され、上記電極部分を封止すると共に上記陽極シートと陰極シートを一体に接合した封止シートからなる構成としたことにより、IC(CPU)の接続用ピンに

シート形電解コンデンサを貫通させることによってICとICソケット間にシート形電解コンデンサを挟み込むことができるようになるため、ICの周辺回路の実装面積を増やしたり、大容量で低ESLのコンデンサをICのすぐ近傍で接続することができるようになり、こにょうな格別の効果を、コンデンサの中では安価な電解コンデンサで提供することができるものであり、その貢献度は大なるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態 1 によるシート形電解コンデンサとこの使用状態を示した 分解斜視図

【図2】

同シート形電解コンデンサにICを接続した状態を示した断面図

【図3】

同シート形電解コンデンサの構成を示した分解斜視図

【図4】

同断面図

【図5】

同シート形電解コンデンサのコンタクト部の構成を示した平面図

図6

同シート形電解コンデンサの電極箔を複数枚積層する場合の構成を示した分解 斜視図

【図7】

本発明の実施の形態2によるシート形電解コンデンサの構成を示した断面図

【図8】

本発明の実施の形態3によるシート形電解コンデンサの構成を示した断面図

【図9】

本発明の実施の形態4によるシート形電解コンデンサの構成を示した断面図

【図10】

従来のCPU周りの状況を示した分解斜視図

【符号の説明】

- 1 I C
- 2 接続用ピン
- 2 a 陽極電源ピン
- 2 b 陰極電源ピン
- 3 ICソケット
- 4 プリント配線板
- 5 シート形電解コンデンサ
- 6, 6 a, 6 b, 6 c, 1 7, 1 8, 1 9, 2 0 貫通孔
- 7, 7a, 7b, 41, 43 コンタクト部
- 8, 25, 33, 45 陰極シート
- 9, 21, 34, 47 陰極電極箔
- 10,44 接続部
- 11, 27, 35, 48 陽極シート
- 12, 23, 36, 50 陽極電極箔
- 13, 22, 29, 51 セパレータ
- 14,30,39,52 封止シート
- 15, 16, 31, 32 絶縁シート
- 2 4 接合部
- 26 陰極電極部
- 28 陽極電極部
- 37 駆動用電解液
- 38 球状のスペーサ
- 40 陰極コネクタ
- 42 陽極コネクタ
- 46,49 凹部

【書類名】 図面

【図1】

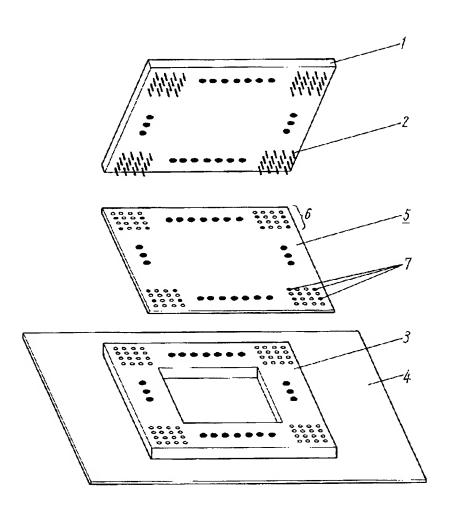
1 I C

5 シート形電解コンデンサ

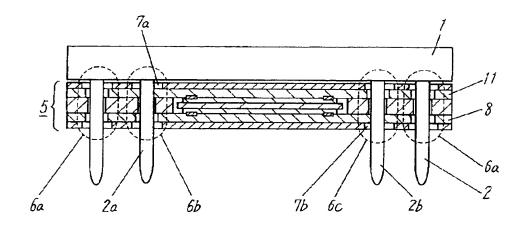
2 接続用ピン 6 貫通孔

3 I C ソケット 7 コンタクト部

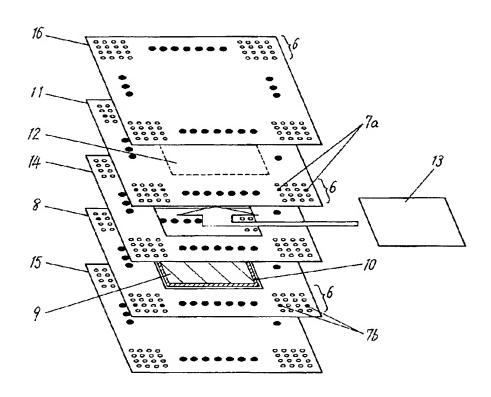
4 プリント配線板



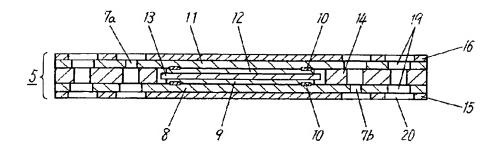
【図2】



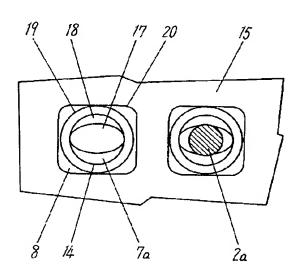
【図3】



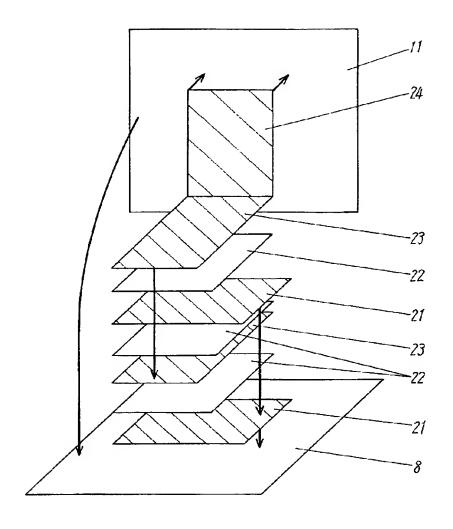
【図4】



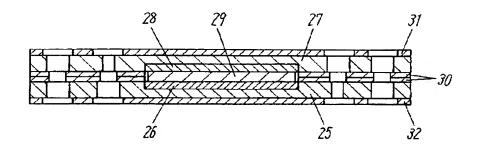
【図5】



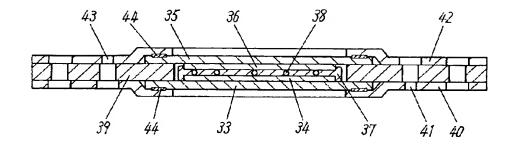
【図6】



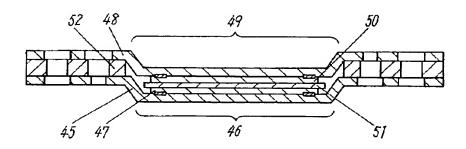
【図7】



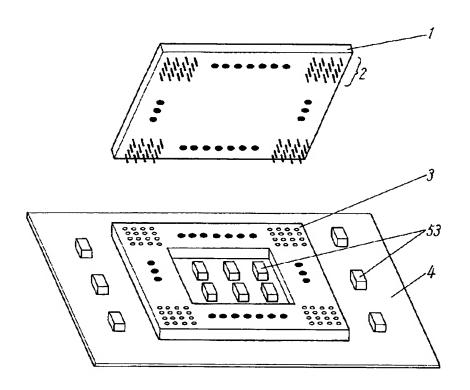
【図8】



【図9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 I C周辺回路の実装面積を増やすことにより大容量で低ESLのコンデンサをICのすぐ近傍で接続できるシート形電解コンデンサを提供することを目的とする。

【解決手段】 陰極電極箔 9 が片面に接合された陰極シート 8 と、陽極電極箔 1 2 が片面に接合された陽極シート 1 1 を対向させてその間に駆動用電解液が含 浸されたセパレータ 1 3 を配設し、これらを封止すると共に陰極シート 8 と陽極シート 1 1 を一体に接合した封止シート 1 4 からなる構成とすることにより、陰極/陽極シート 8 , 1 1 より陰極/陽極電極箔 9 , 1 2 に夫々直接電気を供給することができるためにESRとESLを低減し、かつ製品全体の厚みを薄くすることができる。

【選択図】 図2

特願2003-134087

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社